

7. 電子部品・半導体



業界動向

市場動向

電子部品・半導体市場(除くメモリ)は、2019年はスマートフォンの生産台数減少等を背景に縮小しましたが、2020年は新型コロナウイルス感染拡大により最終製品需要が下振れたものの、セットメーカー等がサプライチェーン寸断を懸念して部品在庫を積み増したことから、市場規模は拡大しました。

半導体メモリ市場は、データセンター投資拡大等を背景に需要拡大が続いているほか、各メモリメーカーが投資に対して慎重だったため需給は比較的タイトで、単価下落は過去比緩やかに推移したこともあり、2020年の市場は拡大しました。

中期的にみれば、電子部品・半導体市場は、大手IT企業によるデータセンター投資の拡大、自動車の電装化に伴う車載向け需要の拡大、5G対応スマートフォン普及を背景に拡大が期待されます。

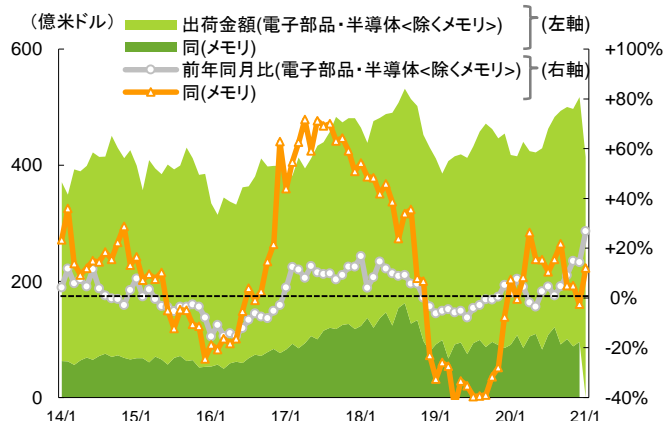
今後の見通し

業界再編動向～製品分野の拡充等に向けた取り組みが加速

半導体業界では、需要の牽引役がIT機器(PC・スマートフォン等)向けから、車載・産業・データセンター向けにシフトする中、相応の財務体力を有する大手半導体メーカーによる、①成長が見込まれる製品分野の強化や、②規模拡大によるコスト競争力の向上、等を目的とした大型M&Aが相次ぎました。この結果、2020年における半導体企業のM&A取引総額は1,180億ドルと過去最高を記録しており、今後も同傾向は続くと考えられます。

電子部品業界では、今後市場成長が期待される車載・産業分野の強化を企図した大型買収の動き等が進むとみられるほか、投資拡大が期待される5G対応基地局向けや、電子部品の搭載員数増加が期待される5G対応スマートフォンの需要取り込みに向け、高周波数帯に対応可能な電子部品の研究開発や投資に各社が注力しています。

図表1 半導体・電子部品出荷動向(直近2月迄)
～サプライチェーン寸断を懸念して在庫積み増し



図表2 世界の売上高上位10社(2019年度)
～大手半導体メーカーが上位を占める

| | 企業名 | | 売上高 (億円) | 営業利益 (億円) |
|----|----------------|---|-------------|--------------|
| 1 | Intel | 米 | 85,385 | 28,104 |
| 2 | TSMC | 台 | 43,816 | 17,511 |
| 3 | SK Hynix | 韓 | 26,724 | 3,091 |
| 4 | Broadcom | 米 | 25,053 | 3,821 |
| 5 | MICRON | 米 | 23,128 | 3,232 |
| 6 | QUALCOMM | 米 | 21,631 | 3,793 |
| 7 | LG Display | 韓 | 20,171 | ▲1,570 |
| 8 | BOE Technology | 中 | 18,729 | 148 |
| 9 | 京セラ | 日 | 15,312 | 851 |
| 10 | 村田製作所 | 日 | 15,033 | 2,420 |

為替レート(年度平均): 109円/USD, 3.5円/TWD, 0.09円/KRW, 15.62円/元

出所: 各社IRより弊社作成

図表3 業界再編事例
～成長分野の強化等に向けた取り組みが加速

| 公表日 | 買収企業 | 対象企業 | 買収金額 (億ドル) |
|----------|--------------------|----------------------|---------------|
| 2019年11月 | 京セラ | AVX Corp | 10 |
| 2020年4月 | 日本電産 | オムロン(車載事業) | 10 |
| 2020年7月 | Analog | Maxim | 220 |
| 2020年9月 | NVIDIA | ARM | 400 |
| 2020年10月 | SK Hynix | Intel(NAND事業) | 90 |
| 2020年10月 | AMD | Xilinx | 350 |
| 2020年10月 | Marvell Technology | Inphi Corp | 100 |
| 2021年3月 | ルネサスエレクトロニクス | Dialog Semiconductor | 59 |

出所: 各社プレスリリースより弊社作成